

関係各位

レンゴー株式会社  
広報部広報課

## “PACK SHOW 2013”に出展いたします —デルタフルートが拓く新たな段ボールの未来をご紹介します—

当社は、公益社団法人日本包装技術協会が主催する包装展『“PACK SHOW 2013” 包装材料・容器展 2013』に出展いたします。

同包装展は、消費者に一番近い存在である包装材料・容器に求められる役割や重要性がますます高まる中、「未来のより良いパッケージ／包装材料・容器が魅せる包装技術」をテーマに開催されるもので、当社は、今年春発表した新規格の段ボール『デルタフルート』を中心に展示いたします。

『デルタフルート』は、缶飲料などの包装に使用されるBフルート（厚さ約3mm）と、贈答箱などに用いられるEフルート（厚さ約1.5mm）の中間の厚みを有する段ボールで、これまでにないレンゴーオリジナルの全く新しい規格です。

“Less is more.” 少資源で大きな価値を生む段ボールの新たなイノベーションとして、地球環境への負荷低減とともに、軽量化、高機能化を実現する、それが『デルタフルート』です。

今回展示では、『デルタフルート』の優れた特徴から、各種包装改善事例のかずかずを総合的に分かりやすくご紹介してまいります。

是非ともご高覧賜りますようご案内申し上げます。

### “PACK SHOW 2013” 包装材料・容器展 2013 <http://www.jpi-expo.jp/tech/index.html>

- 会 期 2013年10月1日（火）～3日（木）10:00～17:00（最終日のみ16:00）  
会 場 東京都立産業貿易センター 浜松町館 4階、5階（受付5階）  
東京都港区海岸1-7-8 TEL：03-3434-4242
- ◆JR山手線・京浜東北線・東京モノレール「浜松町駅（北口）」徒歩5分
  - ◆都営地下鉄・浅草線・大江戸線「大門駅（B2出口）」徒歩5分
  - ◆東京臨海新交通（ゆりかもめ）「竹芝駅」徒歩5分
- 主 催 公益社団法人 日本包装技術協会

### レンゴー出展ブース イメージ図（会場5階）



以上